

2027-2033年中国汽车电子PCB行业发展动态监测 及投资风险评估报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2027-2033年中国汽车电子PCB行业发展动态监测及投资风险评估报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/qclj/1182955.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

《2027-2033年中国汽车电子PCB行业发展动态监测及投资风险评估报告》由华经产业研究院研究团队精心研究编制，对汽车电子PCB行业发展环境、市场运行现状进行了具体分析，还重点分析了行业竞争格局、重点企业的经营现状，结合汽车电子PCB行业的发展轨迹和实践经验，对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判；为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据、海关总署、问卷调查数据、商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 汽车电子PCB行业发展概述

第一节 汽车电子PCB行业定义与分类

一、汽车电子PCB行业概念界定

二、汽车电子PCB行业分类体系

- 1、按应用场景分类（动力电控/智能座舱/车身与照明）
- 2、按产品结构分类（多层板/高密度互连板/厚铜板）
- 3、按工艺等级分类（普通刚性板/刚挠结合板/金属基板）

第二节 汽车电子PCB行业发展历程

- 一、合资引进阶段以单双面板配套汽车仪表与照明
- 二、消费电子外溢带动多层板产能快速扩张
- 三、车规认证体系推动高多层与厚铜板国产化

第三节 汽车电子PCB行业商业模式分析

- 一、以车规料号定点配套的模式
- 二、以高端板材自研与工艺绑定的模式
- 三、以多地产能布局就近供货的模式

第二章 中国汽车电子PCB行业发展环境分析

第一节 中国汽车电子PCB行业政策与法律环境分析

- 一、《印制电路板行业规范条件（2025年本）》
- 二、《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023年）》
- 三、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》

四、《电子信息制造业发展“十五五”规划》

五、《产业结构调整指导目录（2024年本）》

第二节 中国汽车电子PCB行业经济与产业环境分析

一、新能源汽车产销扩张拉动车用电路板需求

二、电子信息制造业营收增长支撑上游配套投入

第三节 中国汽车电子PCB行业社会与需求环境分析

一、安全法规升级提升单车电子配置与电路板用量

二、自动驾驶准入要求强化车载电路板可靠性

第四节 中国汽车电子PCB行业技术与创新环境分析

一、高压平台推动厚铜与高耐压基材工艺升级

二、域控集中化带动高密度互连板用量上行

第五节 中国汽车电子PCB行业进入壁垒分析

一、车规认证体系与整车厂长期验证形成准入壁垒

二、高多层与厚铜板工艺积累形成技术壁垒

三、激光钻孔与曝光设备投入形成资金壁垒

四、车规料号定点与设计导入形成切换壁垒

五、高端覆铜板与铜箔采购渠道形成资源壁垒

第六节 中国汽车电子PCB行业退出壁垒分析

一、车规产线认证投入与客户绑定形成沉没约束

二、专用钻孔与电镀设备转产消费板难度偏大

三、车规料号在制库存与专用物料难以变现

第三章 全球汽车电子PCB行业发展现状分析

第一节 2022-2026年全球汽车电子PCB产量规模分析

第二节 2022-2026年全球汽车电子PCB市场需求分析

第三节 2022-2026年全球汽车电子PCB市场规模与结构分析

第四节 2022-2026年全球汽车电子PCB价格走势分析

第五节 2022-2026年全球汽车电子PCB价格影响因素分析

第六节 全球汽车电子PCB行业区域分布格局

一、日韩台厂商主导车规高阶板材与专利布局

二、中国大陆承接车用中低层板与厚铜板产能

三、东南亚新建产能分流车用电路板订单

第七节 全球汽车电子PCB行业区域市场发展分析

一、亚太地区汽车电子PCB行业运行现状及趋势预测

二、北美地区汽车电子PCB行业运行现状及趋势预测

三、欧盟地区汽车电子PCB行业运行现状及趋势预测

四、其他地区汽车电子PCB行业运行现状及趋势预测

第八节 全球汽车电子PCB行业重点区域发展动态分析

一、亚太地区发展动态

- 1、日本厂商在泰国扩建车规高密度互连板产线
- 2、韩国企业加码越南车用电路板与封装基板产能

二、北美地区发展动态

- 1、美国对进口汽车零部件加征关税并设纳管机制
- 2、美国铜材关税抬升车用电路板与铜箔采购成本

三、欧盟地区发展动态

- 1、欧盟汽车电子投资回流带动电路板本地配套
- 2、奥地利厂商扩建本土高端电路板洁净产能

第九节 全球汽车电子PCB行业重点企业分析

一、臻鼎科技控股（Zhen Ding Tech）

- 1、企业简介
- 2、企业经营态势分析
- 3、企业汽车电子PCB业务发展概况

二、美国TTM科技（TTM Technologies）

- 1、企业简介
- 2、企业经营态势分析
- 3、企业汽车电子PCB业务发展概况

三、奥地利奥特斯（AT&S）

- 1、企业简介
- 2、企业经营态势分析
- 3、企业汽车电子PCB业务发展概况

四、日本旗胜（Nippon Mektron）

- 1、企业简介
- 2、企业经营态势分析
- 3、企业汽车电子PCB业务发展概况

五、日本名幸电子（Meiko Electronics）

- 1、企业简介
- 2、企业经营态势分析
- 3、企业汽车电子PCB业务发展概况

第四章 中国汽车电子PCB行业发展现状分析

第一节 2022-2026年中国汽车电子PCB行业产量规模分析

第二节 中国汽车电子PCB行业需求分析

一、汽车电子PCB需求总量分析

二、汽车电子PCB需求区域分布格局

第三节 中国汽车电子PCB行业市场规模分析

一、汽车电子PCB市场规模分析

二、汽车电子PCB规模区域分布格局

第四节 2022-2026年中国汽车电子PCB行业价格走势分析

第五节 2022-2026年中国汽车电子PCB价格影响因素分析

第六节 中国汽车电子PCB行业大事件分析

一、车规自动驾驶安全标准发布并设定准入门槛

二、汽车电子印制电路板并购整合推高集中度

三、车用高端板材多轮提价并向下游整板传导

第五章 汽车电子PCB行业产业链分析

第一节 汽车电子PCB行业产业链图谱分析

第二节 上游产业分析

一、覆铜板与电子布分析

1、2022-2026年覆铜板与电子布发展现状

2、2027-2033年覆铜板与电子布发展趋势

二、铜箔与环氧树脂分析

1、2022-2026年铜箔与环氧树脂发展现状

2、2027-2033年铜箔与环氧树脂发展趋势

三、激光钻孔与曝光设备分析

1、2022-2026年激光钻孔与曝光设备发展现状

2、2027-2033年激光钻孔与曝光设备发展趋势

第三节 下游产业分析

一、整车厂与一级供应商分析

1、2022-2026年整车厂与一级供应商发展现状

2、汽车电子PCB在整车厂与一级供应商的应用分析

3、2027-2033年整车厂与一级供应商发展趋势

二、动力电池与电驱电控分析

1、2022-2026年动力电池与电驱电控发展现状

2、汽车电子PCB在动力电池与电驱电控的应用分析

3、2027-2033年动力电池与电驱电控发展趋势

三、智能座舱与毫米波雷达分析

- 1、2022-2026年智能座舱与毫米波雷达发展现状
- 2、汽车电子PCB在智能座舱与毫米波雷达的应用分析
- 3、2027-2033年智能座舱与毫米波雷达发展趋势

第四节 上下游产业链对汽车电子PCB行业影响分析

第六章 中国汽车电子PCB行业七大区域发展概况

第一节 华东地区汽车电子PCB行业分析及预测

- 一、华东地区区位特征及经济概况
- 二、2022-2026年华东地区汽车电子PCB市场规模分析
- 三、2022-2026年华东地区汽车电子PCB市场需求分析
- 四、2027-2033年华东地区汽车电子PCB市场前景预测

第二节 华北地区汽车电子PCB行业分析及预测

- 一、华北地区区位特征及经济概况
- 二、2022-2026年华北地区汽车电子PCB市场规模分析
- 三、2022-2026年华北地区汽车电子PCB市场需求分析
- 四、2027-2033年华北地区汽车电子PCB市场前景预测

第三节 东北地区汽车电子PCB行业分析及预测

- 一、东北地区区位特征及经济概况
- 二、2022-2026年东北地区汽车电子PCB市场规模分析
- 三、2022-2026年东北地区汽车电子PCB市场需求分析
- 四、2027-2033年东北地区汽车电子PCB市场前景预测

第四节 华中地区汽车电子PCB行业分析及预测

- 一、华中地区区位特征及经济概况
- 二、2022-2026年华中地区汽车电子PCB市场规模分析
- 三、2022-2026年华中地区汽车电子PCB市场需求分析
- 四、2027-2033年华中地区汽车电子PCB市场前景预测

第五节 华南地区汽车电子PCB行业分析及预测

- 一、华南地区区位特征及经济概况
- 二、2022-2026年华南地区汽车电子PCB市场规模分析
- 三、2022-2026年华南地区汽车电子PCB市场需求分析
- 四、2027-2033年华南地区汽车电子PCB市场前景预测

第六节 西南地区汽车电子PCB行业分析及预测

- 一、西南地区区位特征及经济概况
- 二、2022-2026年西南地区汽车电子PCB市场规模分析

三、2022-2026年西南地区汽车电子PCB市场需求分析

四、2027-2033年西南地区汽车电子PCB市场前景预测

第七节 西北地区汽车电子PCB行业分析及预测

一、西北地区区位特征及经济概况

二、2022-2026年西北地区汽车电子PCB市场规模分析

三、2022-2026年西北地区汽车电子PCB市场需求分析

四、2027-2033年西北地区汽车电子PCB市场前景预测

第七章 中国汽车电子PCB行业市场竞争格局分析

第一节 中国汽车电子PCB行业竞争主体与梯队格局

一、第一梯队为车规认证齐全的规模化上市企业

二、第二梯队为消费板转型车用板的区域厂商

三、第三梯队为专营打样与小批量车用板企业

第二节 中国汽车电子PCB行业整体竞争格局与竞争特点

一、高阶车用板供给向少数认证齐全厂商集中

二、中低层车用板产能充裕且价格竞争偏强

三、国内厂商在厚铜与高压板的份额向上抬升

第三节 中国汽车电子PCB行业竞争五力模型分析

一、现有竞争者之间的竞争强度分析

1、车用板高端供给偏紧而中低端价格竞争偏强

2、认证齐全厂商在车规料号上形成绑定优势

二、潜在进入者威胁分析

1、消费板厂商转型车用板但认证周期偏长

2、上游覆铜板企业向下延伸整板制造业务

三、替代品威胁分析

1、柔性电路板在电池采样场景替代部分刚性板

2、嵌入式器件工艺减少独立电路板配置数量

四、供应商议价能力分析

1、高端覆铜板与超薄铜箔供给集中度偏高

2、树脂与电子布涨价推高整板制造成本

五、购买者议价能力分析

1、整车厂与一级供应商对整板压价能力较强

2、车规客户要求长周期稳定交付与质量追溯

第四节 中国汽车电子PCB行业竞争关键成功要素分析

一、车规认证与料号定点决定高端市场准入

二、厚铜与高多层工艺良率决定成本竞争力

三、产能布局与就近交付决定客户绑定深度

第五节 中国汽车电子PCB行业SWOT分析

一、行业优势分析

1、国内已形成从覆铜板到整板的完整配套链条

2、车规厚铜与高多层板量产能力持续提升

二、行业劣势分析

1、高端高频板材与超薄铜箔自给能力偏弱

2、车规认证周期偏长使新客户导入节奏偏慢

三、行业机会分析

1、智能驾驶与高压平台拉升单车电路板价值

2、海外产能转移为国内厂商打开配套窗口

四、行业威胁分析

1、日韩台厂商在高端车规板材保持技术优势

2、原材料涨价与汇率波动挤压整板毛利

第六节 中国汽车电子PCB行业替代品与潜在进入者竞争分析

一、域控集中化使单板替代多块分立电路板

二、集成化芯片方案减少外围板卡使用数量

三、铝基与陶瓷基板在功率场景分流部分需求

第八章 中国汽车电子PCB行业重点企业分析

第一节 沪士电子股份有限公司

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业汽车电子PCB业务发展情况

四、企业技术水平分析

五、企业发展战略或动态分析

第二节 深圳市景旺电子股份有限公司

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业汽车电子PCB业务发展情况

四、企业技术水平分析

五、企业发展战略或动态分析

第三节 广东世运电路科技股份有限公司

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业汽车电子PCB业务发展情况

四、企业技术水平分析

五、企业发展战略或动态分析

第四节 胜宏科技（惠州）股份有限公司

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业汽车电子PCB业务发展情况

四、企业技术水平分析

五、企业发展战略或动态分析

第五节 深南电路股份有限公司

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业汽车电子PCB业务发展情况

四、企业技术水平分析

五、企业发展战略或动态分析

第六节 崇达技术股份有限公司

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业汽车电子PCB业务发展情况

四、企业技术水平分析

五、企业发展战略或动态分析

第七节 四会富仕电子科技股份有限公司

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业汽车电子PCB业务发展情况

四、企业技术水平分析

五、企业发展战略或动态分析

第九章 中国汽车电子PCB行业投资风险预警分析

第一节 政策风险预警

一、印制电路板规范条件抬高研发与环保门槛

二、出口管制与关税调整扰动车用板材采购

第二节 市场风险预警

一、中低端车用板产能过剩使价格承压

二、整车排产波动影响车用板订单节奏

第三节 技术风险预警

- 一、超厚铜与埋嵌工艺良率提升仍需攻关
- 二、高频板材国产化进程慢于需求增长

第四节 供应链风险预警

- 一、车规级基材与超薄铜箔采购渠道偏窄
- 二、树脂与电子布价格上行抬升材料成本

第五节 经营风险预警

- 一、车规产线资本开支大且回收周期偏长
- 二、原材料涨价传导滞后挤压当期毛利

第十章 汽车电子PCB行业发展趋势研判与策略建议

第一节 全球汽车电子PCB行业发展趋势

- 一、全球车用电路板需求向高压与智驾场景集中
- 二、全球车用电路板高端产能由日韩台厂商主导

第二节 2027-2033年全球汽车电子PCB行业发展趋势预测

- 一、2027-2033年全球汽车电子PCB产量预测
- 二、2027-2033年全球汽车电子PCB需求预测
- 三、2027-2033年全球汽车电子PCB市场规模预测
- 四、2027-2033年全球汽车电子PCB价格走势预测

第三节 中国汽车电子PCB行业发展趋势研判

- 一、高压平台与厚铜工艺升级重塑车用板结构
 - 1、高压平台普及使电池管理板全面转向厚铜工艺
 - 2、车载充电与配电模块要求板材提升耐压与散热
 - 3、超厚铜板材供给偏紧使车用板交期明显拉长
- 二、智能驾驶渗透推动高密度互连板替代提速
 - 1、域控制器集成化带动高阶高密度互连板放量
 - 2、毫米波雷达普及拉动高频板材用量上行
 - 3、智能座舱多屏化提升车用电路板配置密度
- 三、产能出海与原材料涨价并存重塑供给格局
 - 1、东南亚新建车用电路板产能分流国内订单
 - 2、覆铜板与电子布多轮提价推高车用板成本
 - 3、低端车用板产能加速出清而高端供给偏紧

第四节 2027-2033年中国汽车电子PCB行业发展趋势预测

- 一、2027-2033年中国汽车电子PCB产量预测
- 二、2027-2033年中国汽车电子PCB需求预测

三、2027-2033年中国汽车电子PCB市场规模预测

四、2027-2033年中国汽车电子PCB价格走势预测

第五节 中国汽车电子PCB行业发展战略与建议

一、以车规认证与高阶工艺卡位整车配套

1、加快车规认证以获得整车与一级供应商定点

2、推进厚铜与埋嵌工艺量产以提升单板价值

3、绑定头部整车平台长单以稳定高端出货节奏

二、以多地产能与材料自研对冲供给风险

1、布局东南亚与国内双基地以分散交付风险

2、联合上游开发车规板材以削弱涨价影响

3、提升超厚铜与高频板材自给率以稳住毛利

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/qclj/1182955.html>